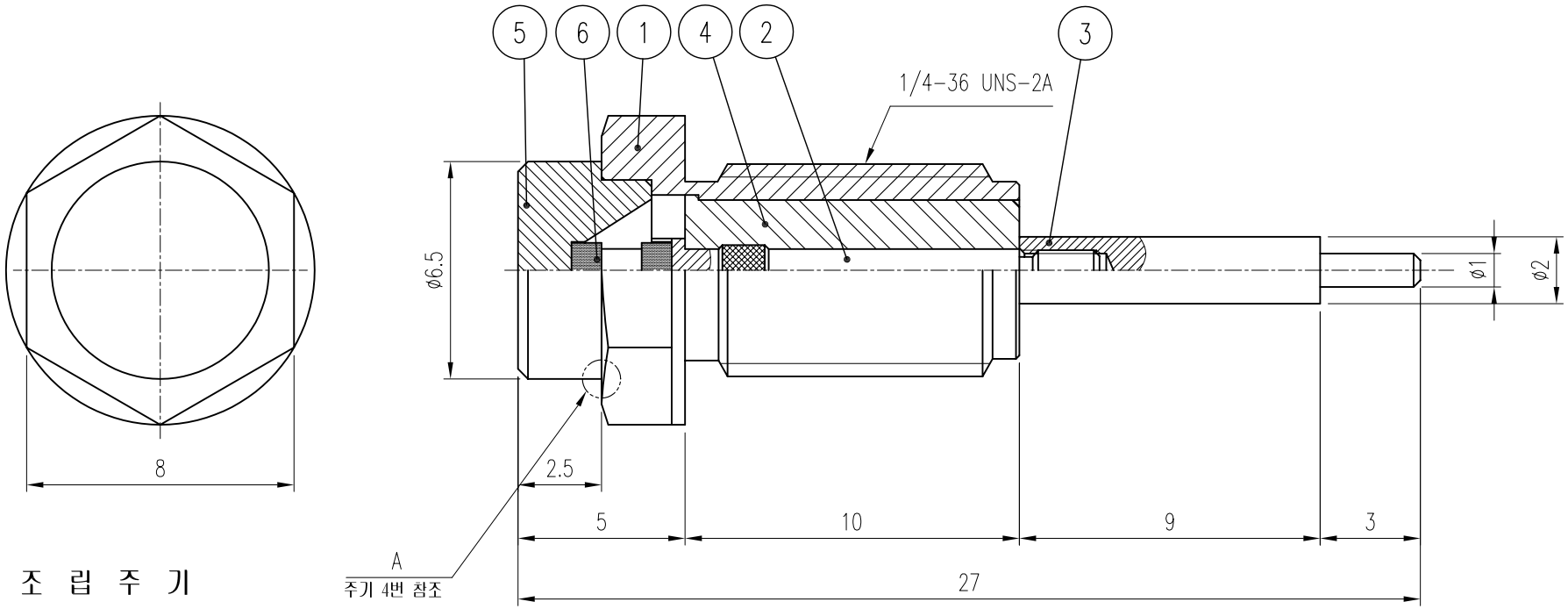
ST \ 가공										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용

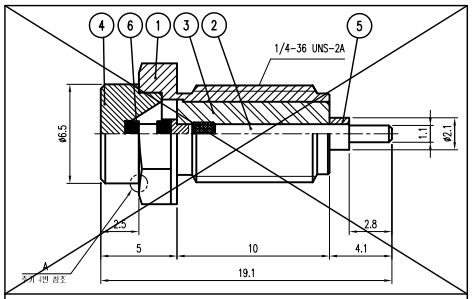
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
1	신뢰성 향상[설변No.연구2006-234] (PIN회전 방지 널링 추가)	김은희	윤상진	2006. 12. 5.
2	신뢰성 향상[설변No.연구2007-003] (SPEC변경으로 인한 PIN 변경 및 저항 값 변경)	김은희	윤상진	2007. 1. 8.



조 립 주 기

1. 절연체에 PIN을 밀어 넣어 조립한다.
2. 조립된 절연체를 BODY에 끼운다.
3. 저항을 삽입한다.
4. COVER를 억지끼움한다. <표시 A부분 밀착 시킬 것.>
5. 4번까지 조립된 상태에 INSERT를 억지끼움한다.
6. 멀티미터기로 순수 저항 값을 측정할 것.

2 ~~<저항값 48~50Ω>~~ <저항값 48~52Ω>



설변 전 VER.1

	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
	6	RESISTOR	1			DRE00057-N/1 (XA118)
2	~~5~~	~~INSERT~~	~~1~~	~~MBsBD~~	~~Gold Plate~~	~~M2016~~
	5	COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCV00013-5/1 (L2032)
	4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01469-N/1 (H2346)
2	3	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT01841-5/1 (E2547)
1	2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT01842-5/1 (E2526)
	1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01700-5/1 (D2496)

대체가능재질	년월일	2006. 9. 11.
공통공차 소수 각도 분수	승인	
	검도	
재질	제도	
열처리	직성부서	연 구 소
보호피막처리	척도 5/1	단위 mm 중량 ___

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 SMA-J-내장형 TERM VER.2

A4

도번 TM00025-7/1

K314-953-002